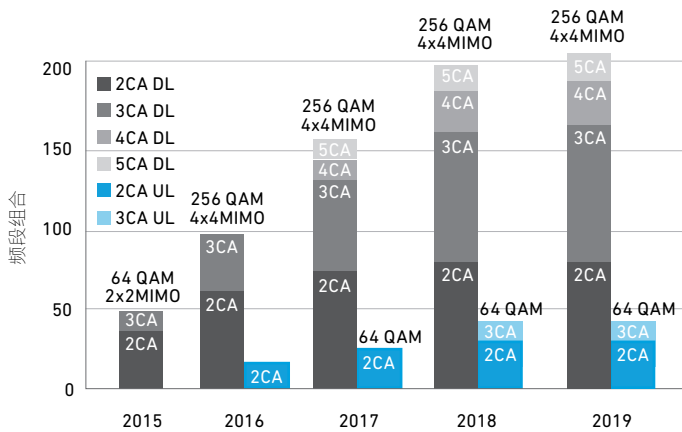


随着 RF 复杂性不断提升, 实施高级载波聚合 (CA) 会耗费宝贵的资源 and 时间。这些难题的根源在于不同运营商与消费者的要求存在冲突。Qorvo 可提供所需解决方案, 帮助手机 OEM 最大限度降低合规风险和避免产品发布延迟。

## 载波聚合的逐年演进



RF 前端复杂性不断上升。运营商正在使用 CA 和 MIMO (多路输入/多路输出) 技术来提高容量和数据下行/上行速度。

## RF 前端插入损耗与天线功率

带来 RF 挑战的智能手机功能

- 全屏
- 覆盖天线区域的面部识别功能
- 载波聚合使用和频段的增加
- MIMO 需要 8-10 根天线, 而几年前只需要 2-3 根
- HPUE (高功率用户设备; 即  $P_{out} \geq 26dBm$ )
- 客户的总辐射功率要求提高



**Qorvo 可以解决这些难题**

(完结)

# RF FUSION<sup>TM</sup> LTE

Qorvo 可帮助您交付世界上最先进的移动设备。RF Fusion LTE 产品组合包含多个高性能模块，能够以业界最小的尺寸实现全局载波聚合 (CA) 频段覆盖。

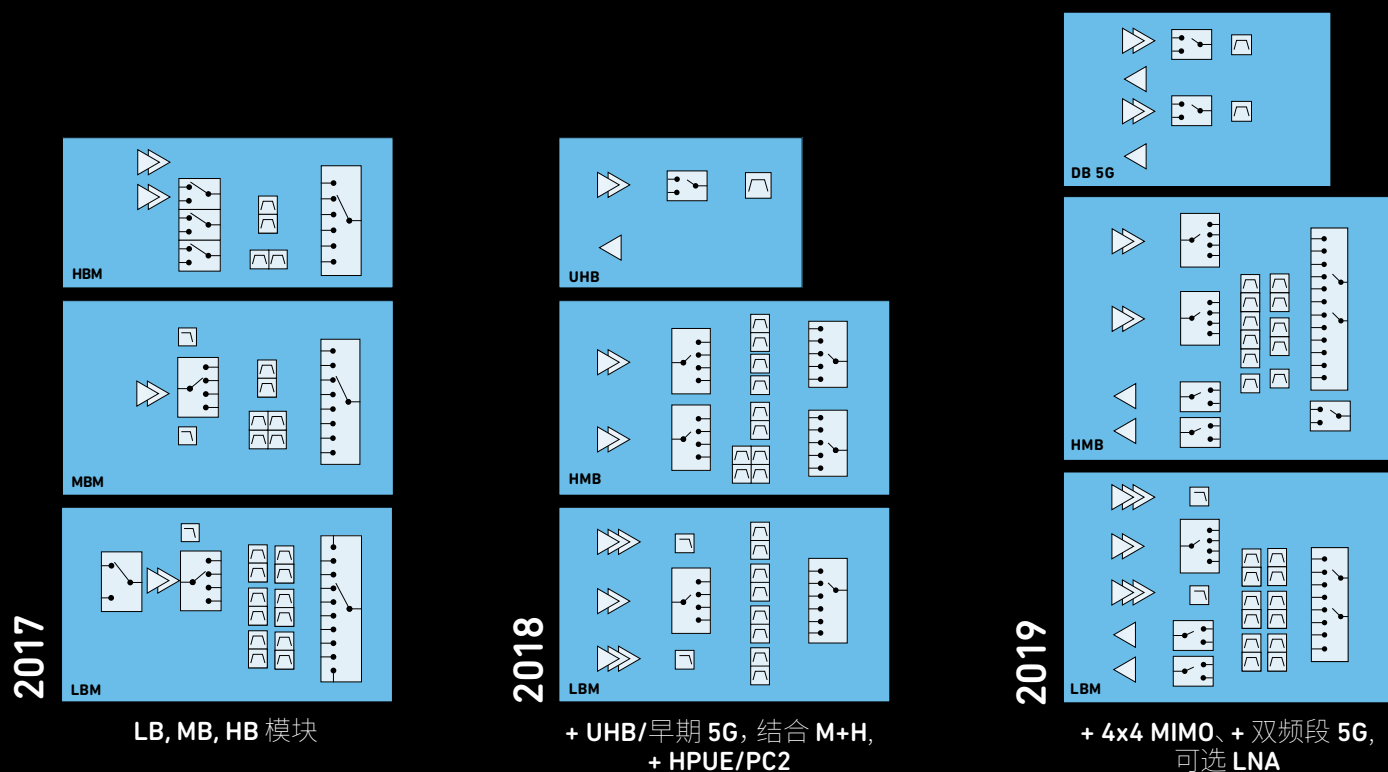
- 解决高级 RF 的复杂性
- 提供完整的全局载波聚合 (CA) 平台
- 提供旗舰性能
- 加速 OEM 的上市时间
- 实现小型 RF 解决方案尺寸
- 广泛的产品组合可满足诸多子市场的需求

## 2018 RF Fusion LTE 解决方案: S-PAD 的演变

载波聚合 PAMiD

性能更高  
集成度更高

高阶 CA, MIMO



## RF Fusion 路线图

2016  
LB/MB/HB

2017  
LB/MB/HB + LNAs 和 PC2

2018  
LB/HMB/UHB

2019  
LB/HMB/UHB + 5G NR